

PCT

特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類7 B24B 37/04, 37/00, H01L 21/304, 21/68	A1	(11) 国際公開番号 (43) 国際公開日	WO00/69597 2000年11月23日(23.11.00)
<p>(21) 国際出願番号 PCT/JP00/03159 (22) 国際出願日 2000年5月17日(17.05.00)</p> <p>(30) 優先権データ 特願平11/135631 1999年5月17日(17.05.99) JP 特願平11/135637 1999年5月17日(17.05.99) JP 特願平11/135652 1999年5月17日(17.05.99) JP</p> <p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 株式会社 柏原機械製作所 (KASHIWARA MACHINE MFG. CO., LTD.)[JP/JP] 〒582-0004 大阪府柏原市河原町1番22号 Osaka, (JP)</p> <p>住友金属工業株式会社 (SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD.)[JP/JP] 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号 Osaka, (JP)</p> <p>(72) 発明者; および (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ) 堀口 明(HORIGUCHI, Akira)[JP/JP] 〒639-0223 奈良県香芝市真美ヶ丘7丁目12番11-103 Nara, (JP)</p> <p>磯部 健(ISOBE, Ken)[JP/JP] 〒575-0002 大阪府四条畷市岡山2丁目1-38 Osaka, (JP)</p>		<p>田中丙午(TANAKA, Heigo)[JP/JP] 〒847-0124 佐賀県唐津市浦5030-2 Saga, (JP)</p> <p>福島富夫(FUKUSHIMA, Tomio)[JP/JP] 〒583-0008 大阪府藤井寺市大井3丁目1-22 Osaka, (JP)</p> <p>村田院英(MURATA, Kiyohide)[JP/JP] 〒662-0872 兵庫県西宮市高座町16-30 Hyogo, (JP)</p> <p>竹田恒雄(TAKEDA, Tsuneo)[JP/JP] 〒619-1303 京都府相楽郡笠置町字笠置奥田19番地 Kyoto, (JP)</p> <p>宇須良晃(UZU, Yoshiaki)[JP/JP] 〒636-0811 奈良県生駒郡三郷町勢野東6-7-2</p> <p>ファーミール若草B-201 Nara, (JP)</p> <p>松本 弘(MATSUMOTO, Hiroshi)[JP/JP] 〒636-0822 奈良県生駒郡三郷町立野南2-23-3 Nara, (JP)</p> <p>(74) 代理人 弁理士 生形元重, 外(UBUKATA, Motoshige et al.) 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4丁目6番15号 Osaka, (JP)</p> <p>(81) 指定国 DE, US</p> <p>添付公開書類 国際調査報告書 補正書・説明書</p>	
<p>(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR POLISHING DOUBLE SIDES</p> <p>(54)発明の名称 両面研磨方法及び装置</p> <p>(57) Abstract A method of polishing the double sides of a plurality of works simultaneously by rotating a plurality of carriers between upper and lower rotating surface plates, comprising the steps of forming the works (400) integrally with the carriers (500) on the outside of a polishing device main carriers (500) on the outside of a polishing device main body (110), feeding the works (400) onto a rotating surface plate (111) on the underside of the polishing device main body (110) with the works formed integrally with the carriers (500), injecting liquid such as water from the upper side rotating surface plate when the upper side rotating surface plate is raised after the double sides are polished, holding the plurality of works (400) on the lower side rotating surface plate (111) after the double sides are polished, enabling the works (400) to be discharged automatically from the lower side rotating surface plate (111), providing a brush storage part (180) and a dresser storage part (190) near the polishing device main body (110), and frequently treating a polishing cloth installed on the opposed surfaces of the upper and lower rotating surface plates with a brush and a dresser.</p>			